導電化被膜形成システム

1工程で厚さ1マイクロメートル

信頼性・歩留まり向上

FPCコネクト　海外企業から受注

【横浜】FPCコネクト（横浜市青葉区、近藤敏文社長、045・974・0809）は、多層フレキシブルプリント基板（FPC）向けに、導電化被膜を形成できる製造システム「ELF（エルフ）プロセス」を開発した。信頼性が高く、歩留まりが良いのが特徴。第1弾として、有機エレクトロ・ルミネッセンス（EL）ディスプレーの搭載が予想される米アップルの新型スマートフォン「iPhone（アイフォーン）」向けにFPCを受注した海外メーカーの採用が決まった。

一つのプロセスで厚さ1マイクロメートル（マイクロは100万分の1）の導電化被膜を形成できる。独自の縦型搬送方式でFPCやプリント基板に無電解銅メッキとフラッシュ銅メッキを連続して施す。直径50マイクロメートル程度の小径ビアホールを有する多層FPCなどの銅メッキに有効だという。

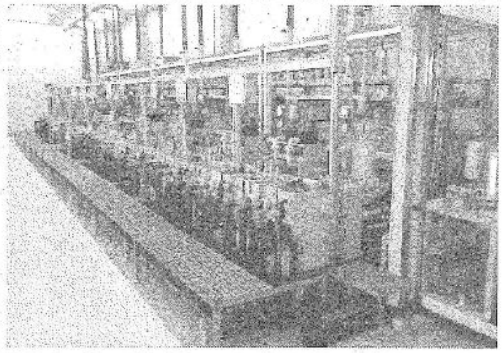
FPCなどの小径ビアホールに施す銅メッキは、導電化処理の段階で被膜を厚くする必要がある。従来は無電解銅メッキを厚くしたり、別装置でフラッシュ銅メッキを行ったりする方法しかなく、高コストや信頼性低下の原因となっていた。

ELFプロセスは同一装置内で銅メッキを連続処理できるため「信頼性や歩留まりが大幅に向上する」（近藤社長）。これが決め手となり、新型アイフォーン向けFPCを手がける海外メーカーに専用の銅メッキ装置を4月に納入する。量産開始は5月の予定だ。

同プロセス用メッキ装置の消費税抜きの価格は2億円程度。ロール式、枚葉式の基板に対応でき、両面に小径ビアホールがある基板に適している。

今後は「高密度実装用プリント基板（HDI）やパッケージ基板向けに応用分野を広げて売り込む」（同）としている。

FPCコネクトは2004年の設立。主な事業はFPC製造関連装置や資材、薬品などの開発。16年3月期売上高は約10億円。



ロールタイプの縦型搬送式銅メッキ装置

テストベッド　無償提供

富士通　大規模IoT向け

富士通は大規模IoT（モノのインターネット）システム向けテストベッド（実証環境）を無償で提供する。IoTアプリケーション（応用ソフト）ビス「K5 IoTプラットフォーム」をテストベッドとして提供する。センサーから収集した大量データを効率的に分散して処理できるように、富士通研大量データをクラウド側とエッジコンピューター側に自動的に振り分けることが可能。

利用者はデータの所在管理や効率的な分散処理を行う上で悩みを抱えCT）の「IoTテストベッド事業および地域データセンター事業」に係る助成交付対象事業」で採択を受けた。利用者はテストベッドの活用状況に関する報告書を提出することで無償で利用できる。

負荷に応じ回数制御

富士電機　電源用IC2種

富士電機は負荷に応じてスイッチング回数を制御することで、電力損失を抑える電源用IC2種の試作を始めた。例えばテレビを視聴せずに録画のみを行っている場合や、工作機械で通電していても運転していない場合などの軽負荷時に、スイッチング回数を減円、同14―29トルで最大さくなる軽負荷時

東京五輪向け出荷増期待

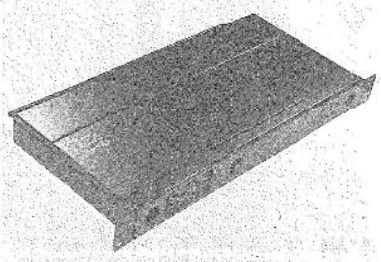
「放送用ブレーカーボックス」　横浜電子

横浜電子（横浜市保土ケ谷区、神田一弘社長、045・334・0681）の放送関連業界向けブレーカーボックス「T4・T5型電源ユニット」の販売が好調だ。約5年間で累計約650台を販売した。ラック内電源を容易に分配し供給できるのが特徴。スタジオなどの業務用放送機器や映像機器と使う。T4型のブレーカー容量は最大20アンペアで、消費税抜きの価格は14万円。T5型の容量は最大30アンペアで同16万円。

限られた場所に設置でき、設置工事がしやすいことから、工事現場の人からも好評としている。

2015年から出荷台数が伸びており、年間100台を超える。神田社長は東京五輪・パラリンピック向けの需要として「中継車や映像基地局など車載向けで（出荷を）増やしたい」と期待する。（横浜）

file いい話



ラック内電源を容易に分配し供給できる